

[首页](#) [学会介绍](#) [组织机构](#) [行业新闻](#) [专家讲坛](#) [成果转化](#) [培训](#) [科普](#) [水平认证](#) [学会期刊](#) [国际合作](#) [承能服务](#) [联系我们](#)

当前位置: [中国电子学会](#) > [专业分会](#) > [第十八届电子封装技术国际会议 \(ICEPT 2017\) 成功召开](#)

## 第十八届电子封装技术国际会议 (ICEPT 2017) 成功召开

发布时间: 2017-11-2 11:46:34

8月16至19日, 由中国电子学会、中国科学院微电子研究所、国际电气电子工程师联合会电子元件封装和生产技术学会 (IEEE-CPMT, 技术主办)、哈尔滨工业大学主办, 中国电子学会电子制造与封装技术分会、哈尔滨工业大学先进焊接与连接国家重点实验室承办的第十八届电子封装技术国际会议 (The 18th International Conference on Electronics Packaging Technology, ICEPT 2017) 在中国哈尔滨太阳岛花园酒店举行, 来自美国、英国、奥地利、法国、德国、荷兰、瑞典、日本、韩国、新加坡、马来西亚、印度、中国大陆、中国香港、中国台湾等近20个国家和地区的400余名专家学者、工业界代表参加大会, 交流电子封装技术领域的关键技术和最新进展。

8月16日上午的开幕式由大会共主席荷兰代夫特理工大学张国旗教授主持。首先由国际电气电子工程师联合会电子元件封装和生产技术学会主席Jean Trehwella和大会主席、中国科学院微电子研究所所长叶甜春教授, 分别代表IEEE-CPMT学会和ICEPT大会委员会向大会荣誉主席、中国电子学会电子制造与封装技术分会电子封装分会荣誉理事长毕克允教授颁发纪念奖牌, 以表彰其多年来对ICEPT会议的发展建设作出的杰出贡献。随后大会主席叶甜春教授讲话宣布会议开幕。



大会主席叶甜春开幕式致辞



大会主席叶甜春教授向荣誉主席毕克允教授颁发终身成就奖牌

开幕式之后, IEEE-CPMT主席Jean M. Trehella女士、香港中文大学C.P. Wong教授、美国佐治亚理工学院封装研究中心主任Rao R Tummala教授、日月光高级技术顾问William Chen先生、中国JCET的Ming Liu博士、日本的Tadatomo Suga教授和Katsuaki Suganuma教授等14位国内外专家作大会特邀报告。荷兰Delft理工大学的张国旗教授、IEEE-CPMT前任主席、香港科技大学的Ricky Lee教授、美国Lamar大学的樊学军教授、哈尔滨工业大学王春青教授共同主持了大会。



IEEE-CPMT主席Jean M. Trehella女士作报告

本次会议吸引了近20个国家和地区的400余名专家学者和工业界代表, 会议论文分为9个专题, 分别是先进封装与系统级封装、封装材料与工艺、封装设计与模拟、互连技术、封装制造技术与设备、质量与可靠性、固态照明封装与集成、微波与功率器件封装、新兴领域封装等。总计收到投稿摘要430篇, 通过全文审稿最终录用的论文共计369篇, 其中口头报告103篇, 海报展示266篇。大会另设7个分会场进行口头报告, 共28个Session, 其中分会场主题特邀报告(Keynote) 9篇。会议期间, 根据国际国内的行业热点问题还举办了专题培训班, 邀请业界资深专家就扇型封装、先进封装材料、TSV、封装可靠性等技术进行短期课程培训, 学员反响热烈。此外, 与会专家通过展览展示、专题讲座、特邀报告、主题论坛、分会报告、论文张贴等形式积极交流了电子封装技术领域的最新进展。

本次会议对国际上重点、热点前沿科学技术进行了深入的讨论和研究, 促进了国内外高校之间的互相沟通, 加强了学术界与工业界的联系, 促进了青年学者与老一辈科学家之间互相交流。

CopyRight @ 2007-2008 中国电子学会 All Rights Reserved

地址: 北京市海淀区玉渊潭南路普惠南里13号楼 通信地址: 北京165信箱 邮编: 100036 联系电话: 68283461

京ICP备12041980号

京公网安备110108003006号